



2026/02

景美科技 (CMAT)

全球信賴的半導體測試介面核心專家

先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造

Certain Micro Application Technology
INVESTOR CONFERENCE

7899.TW

興櫃掛牌：2026年2月25日(半導體類股)

免責聲明



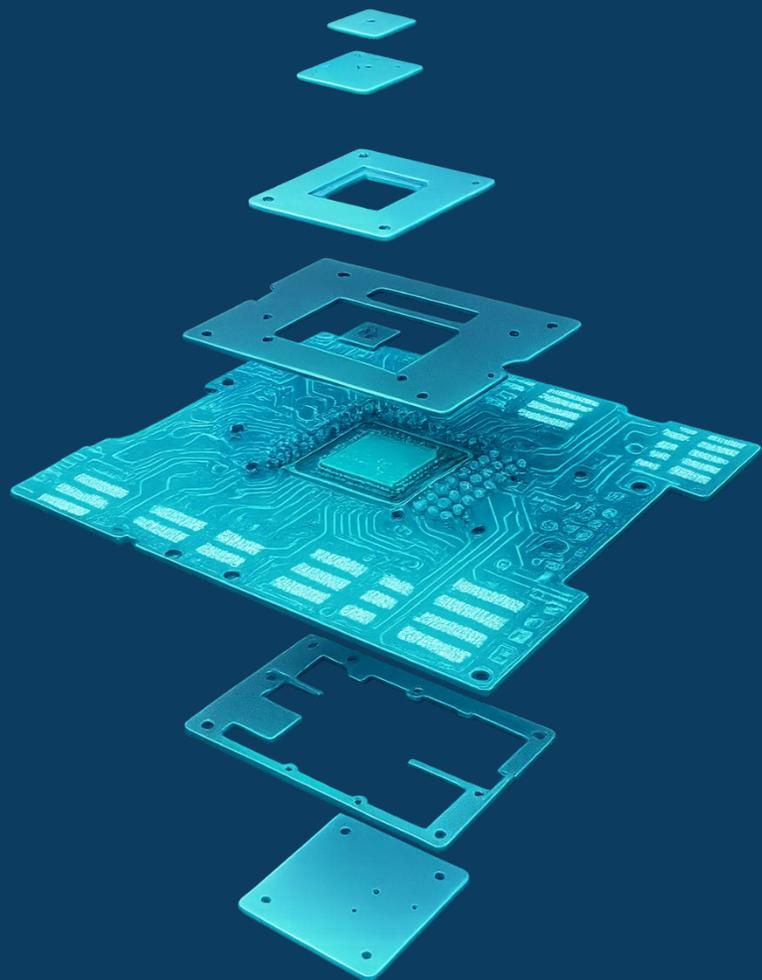
- 除過去資料外，本簡報資料所列事項若為前瞻性看法，可能受重大風險和不確定性因素影響而與實際結果有所差異。
- 本簡報中如有對未來之展望，係反映本公司截至目前為止對於未來之看法，如未來有因任何事件或環境變遷，本公司並不負有更新資料之責任。
- 本簡報所作有關本公司財務上、業務上、Q&A之說明，可能與未來實際結果存有差異。其原因可能來自各種因素，包括但不限於市場需求、各種政策法令與整體經濟現況之改變，及其他本公司無法掌控之風險等因素。
- 未經本公司許可，不可複製、修改、重新編譯、刪減或傳送本簡報任何內容，或將任何該等內容用於商業用途。

7899.TW

全球信賴的半導體測試介面核心專家

(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)

Content



- 1 公司簡介
- 2 市場觀點
- 3 財務資訊
- 4 投資亮點
- 5 參考資料

7899.TW

全球信賴的半導體測試介面核心專家

(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)

景美科技 7899.TW

全球信賴的半導體測試介面核心專家

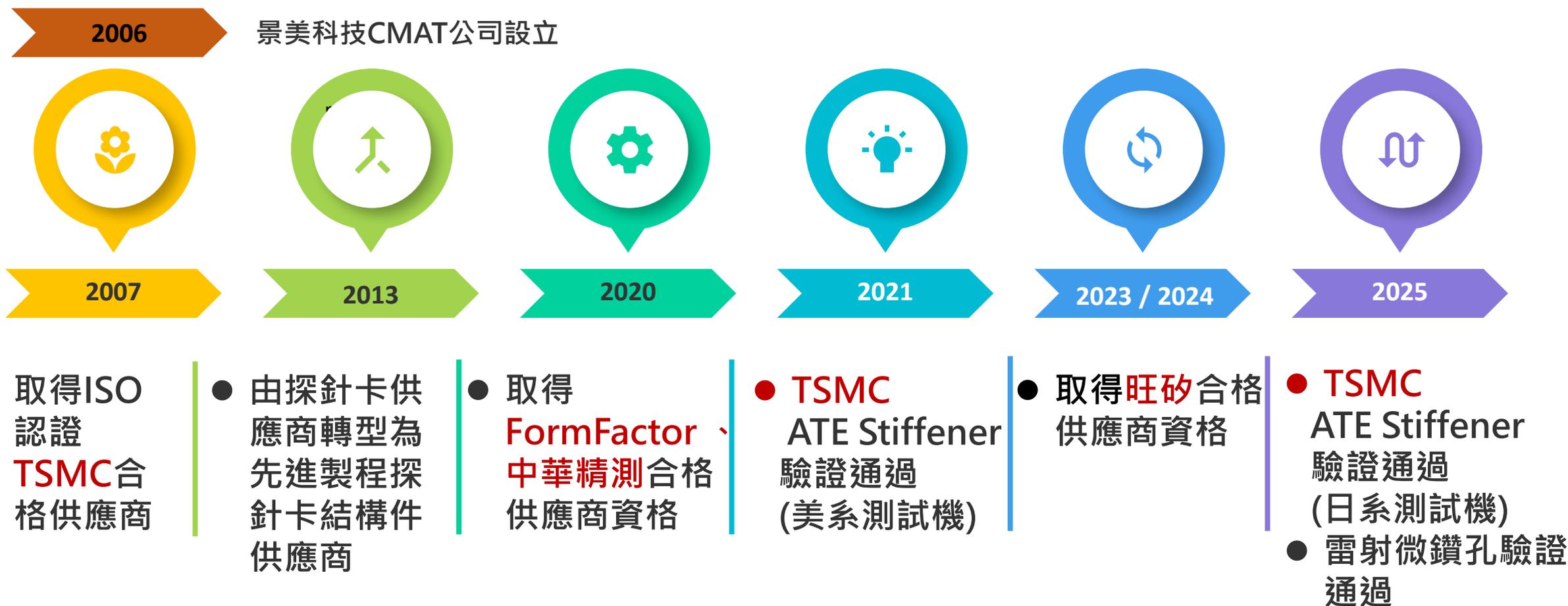
(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)



公司簡介

01

二十年深耕 成就不可取代的產業地位



擴充產能 滿足未來先進製程的爆發性需求

公司概况與產能擴充計畫

資本額：2.29 億元 董事長：陳吉良 總經理：羅麗文

關鍵資訊

 營運總部：台灣(土城)

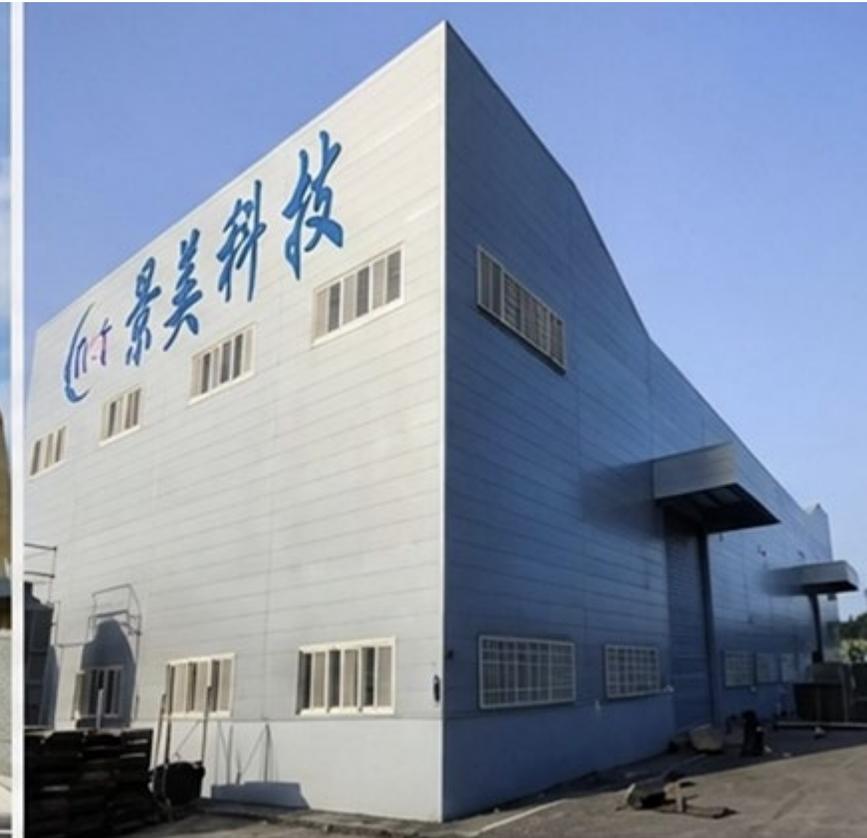
 集團員工人數：139人
(研發人員佔比15%)

產能擴充里程碑

 宜蘭利澤一廠：已啟用 (2021)

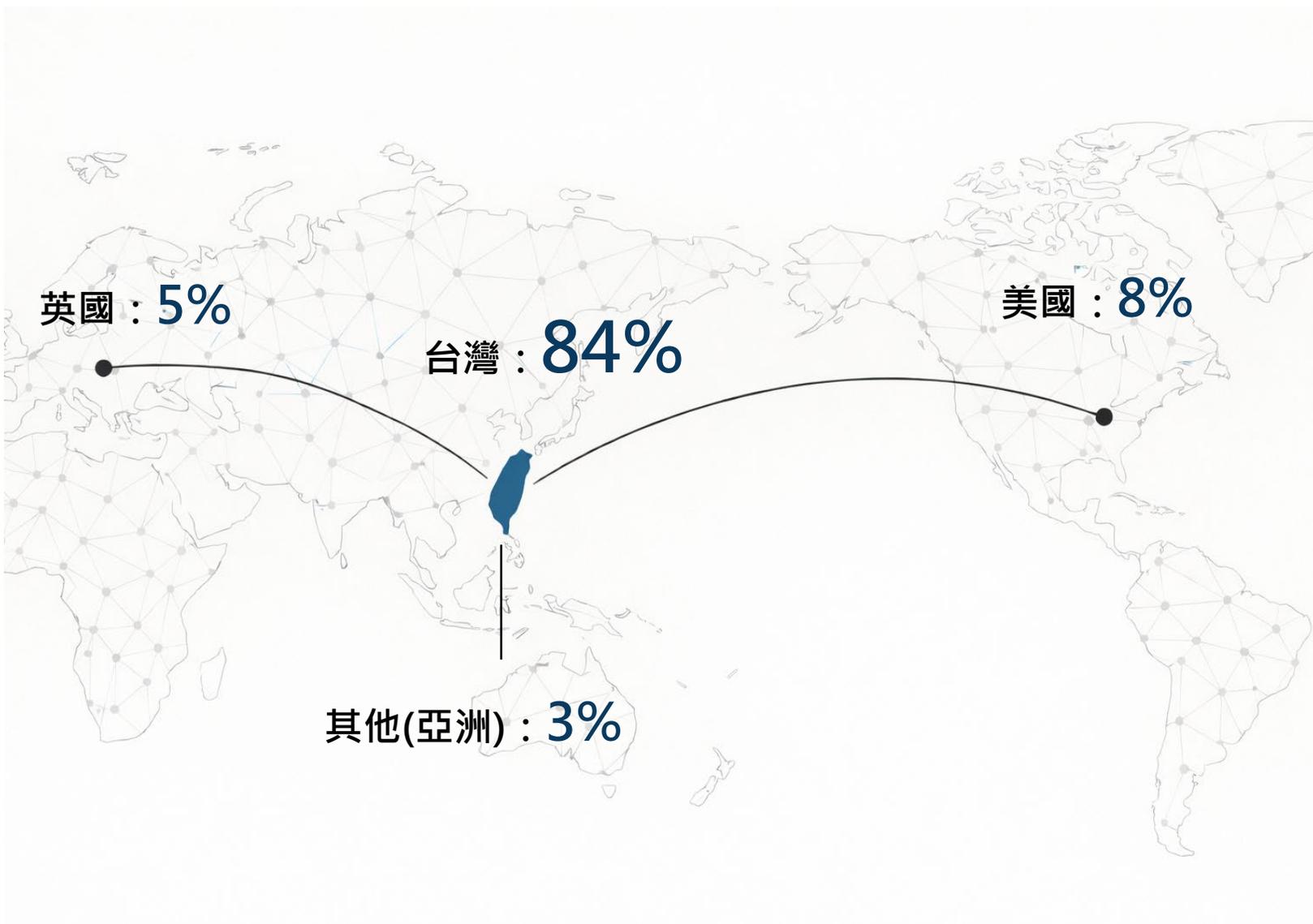
 宜蘭利澤二廠：已啟用 (2023)

 宜蘭利澤三廠：將啟用 (2028)



擴產計畫是為了因應~未來幾年由AI驅動的市場增長需求

立足半導體聚落 服務全球頂尖客戶



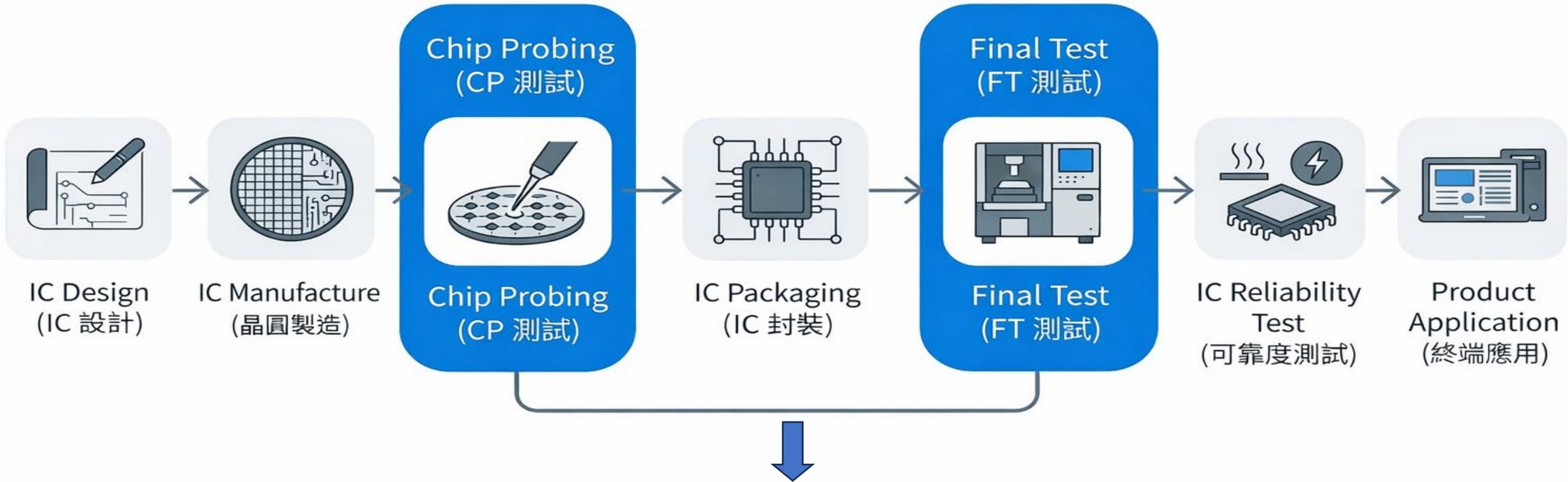
未來五年先進製程產能，
近八成仍在台灣。



我們的擴產計畫與客戶的發展藍圖緊密結合，確保能就近提供最即時、最深度的服務。

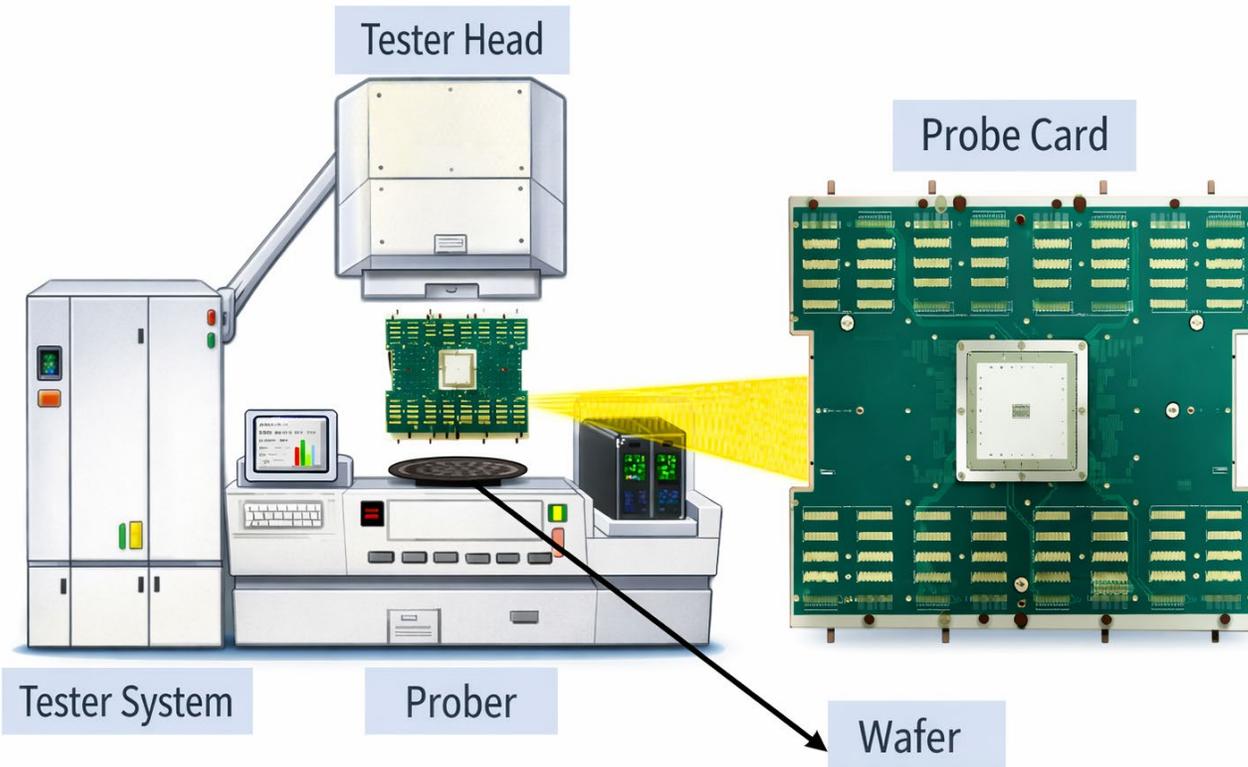
景美科技產品 IC 產業鏈之位置

晶圓前段CP 及 後段測試FT的關鍵節點



「核心產品：探針卡結構件為關鍵優化節點」

為最先進的晶片測試 提供不可或缺的精密基礎



核心業務

先進製程探針卡-- 結構件設計製造

我們設計和製造探針卡中的關鍵結構件，確保數以萬計的微細探針能夠在微米級的精度下穩定運作。

先進製程探針卡-- 微細鑽孔加工

我們的精密鑽孔技術是實現高密度、高頻寬的基礎，對AI和GPU晶片至關重要。

景美科技 7899.TW

全球信賴的半導體測試介面核心專家

(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)



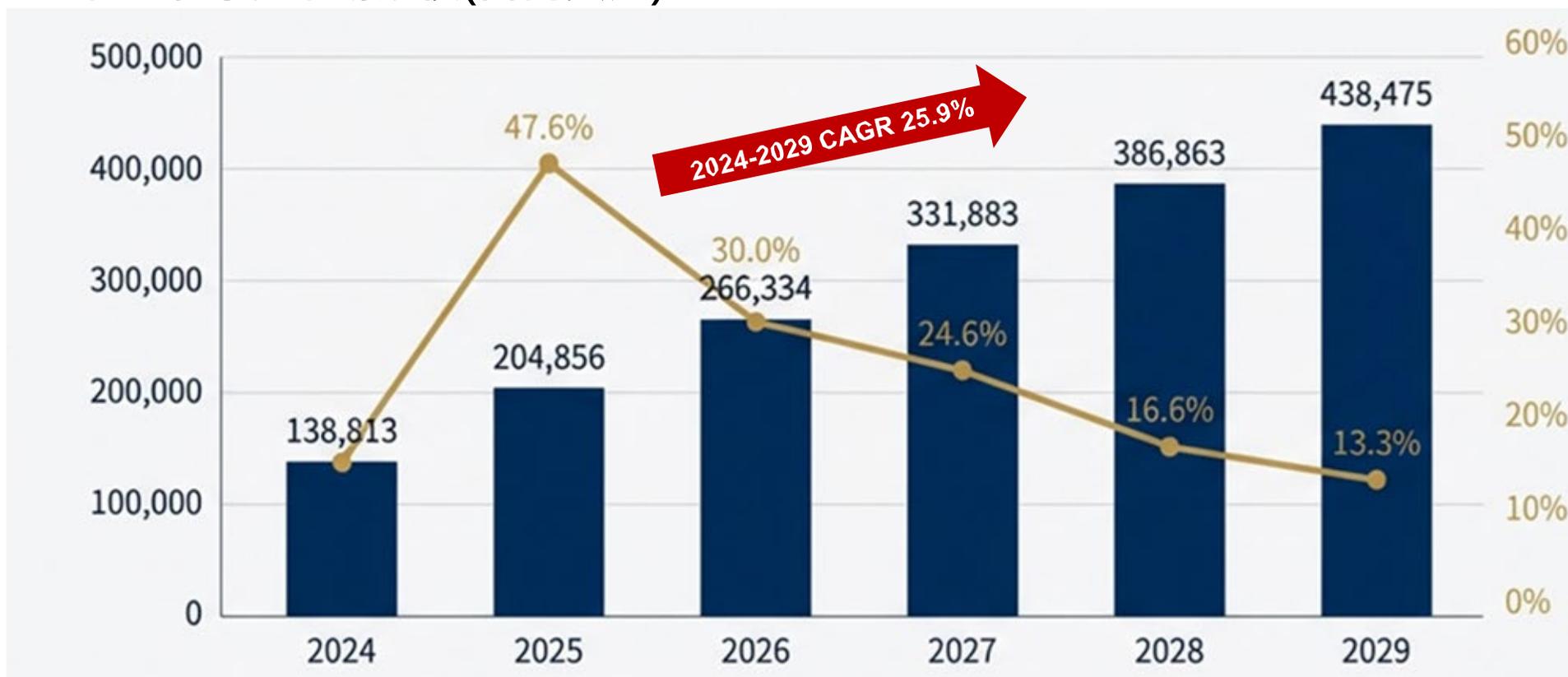
市場觀點

02

AI革命帶動半導體需求呈指數級成長

AI應用的爆發性需求是未來五年半導體最關鍵的成長動能

全球AI半導體市場規模(百萬美元)



預估至2029年，市場規模將達4,385億美元，2024-2029年複合成長率高達25.9%。

AI應用將是未來五年晶圓代工產業最關鍵成長動能

晶圓代工營收影響因素		2025	2026	2027~2030年
需求面	雲端AI應用帶動AI加速器與AI ASIC需求動能。	↑★★★★	↑★★★★	↑★★★
	邊緣AI落地，首波聚焦手機、NB/PC、智慧眼鏡，智慧家庭、工業應用等仍待時間發酵。	↑★	↑★	↑★★★
	IDM委外代工需求趨勢穩定。	↑★	↑★	↑★
	地緣政治不確定性干擾晶片需求。	↑★	↓★	-
	IC載板材料缺貨可能影響部分產品出貨。	↓★	↓★	-
供給面	5奈米及以下先進製程持續挹注營收成長。	↑★★★★	↑★★★★	↑★★★
	先進封裝技術滿足客戶高階AI晶片需求。	↑★★★	↑★★★	↑★
	中國半導體自主化發展，成熟製程產能續開出。	↑★	↑★	↑★★★
	美國續執行半導體出口管制，抑制中國先進製程供給。	↓★	↓★	↓★

註：影響該年營收程度，↑表示有正向影響，↓表示有負向影響，★越多表示影響性越大，-表示無影響或待觀察。

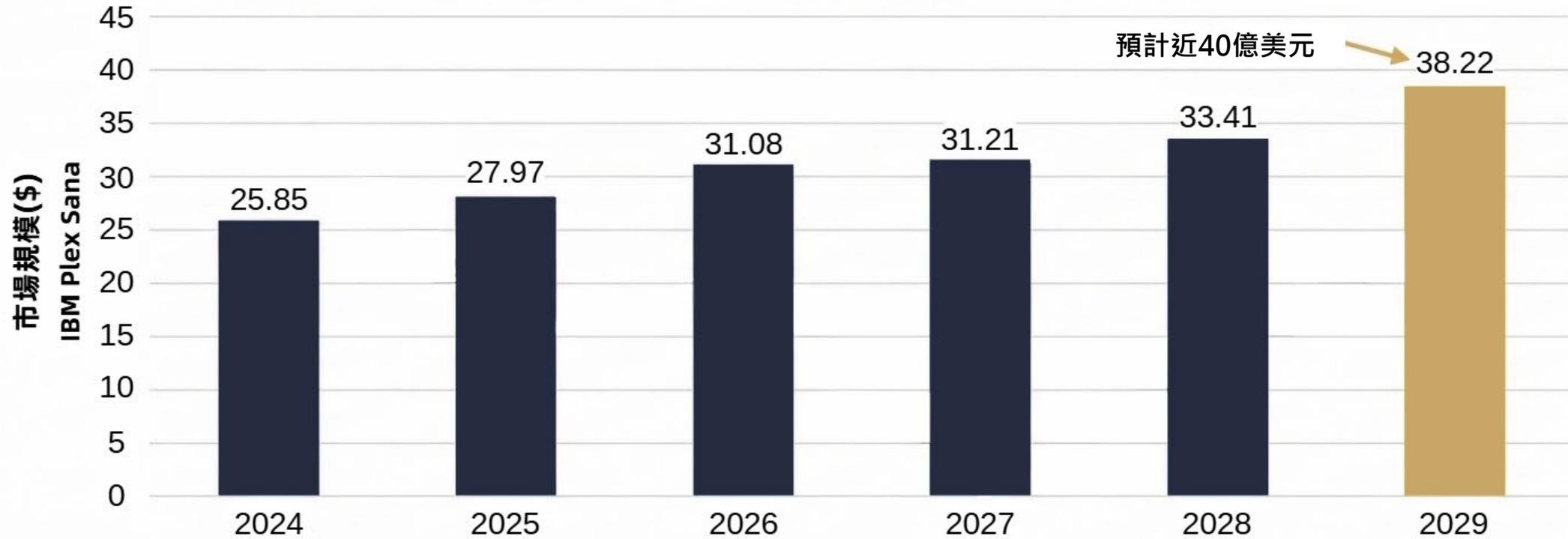
資料來源：DIGITIMES，2025/11

全球半導體探針卡規模 預計2029年增長至近40億美元



複合年增長率顯示強勁動能，顯示TechInsights 與Yole市場共識數據

單位：億美元



Noto Sans TC	2024	2025	2026	2027	2028	2029
市場規模平均值	\$25.85	\$27.97	\$31.08	\$31.21	\$33.41	\$38.22
年增長率	22.92%	8.18%	11.12%	0.41%	7.05%	14.42%

全球半導體市場走勢的樂觀預期合理預計全球探針卡市場規模未來3-5年仍將呈快速發展趨勢

資料來源：TechInsights, Yole (2024-2029 Forecast).

2024 年度全球半導體前十大探針卡廠商市場佔有率

TechInsights : 2024 年度			
排名	廠商名稱	國家/地區	市占率
1	FormFactor	美國	23.58%
2	Technoprobe	義大利	22.22%
3	MJC	日本	13.33%
4	旺矽科技	臺灣	7.38%
5	JEM	日本	4.74%
6	強一股份	中國大陸	3.25%
7	Nidec SV Probe Pte. Ltd.	新加坡	2.81%
8	Korea Instrument CO., Ltd.	韓國	2.47%
9	TSE CO., Ltd.	韓國	2.16%
10	思達科技股份有限公司	臺灣	1.93%
合計	-	-	83.86%

Yole : 2024 年度		
廠商名稱	國家/地區	市占率
FormFactor	美國	24.90%
Technoprobe	義大利	16.31%
MJC	日本	13.87%
旺矽科技	臺灣	7.74%
JEM	日本	4.93%
強一股份	中國大陸	3.42%
Korea Instrument CO., Ltd.	韓國	2.77%
TSE CO., Ltd.	韓國	2.24%
思達科技股份有限公司	臺灣	2.11%
Nidec SV Probe Pte. Ltd.	新加坡	2.03%
-	-	80.30%

景美科技 7899.TW

全球信賴的半導體測試介面核心專家

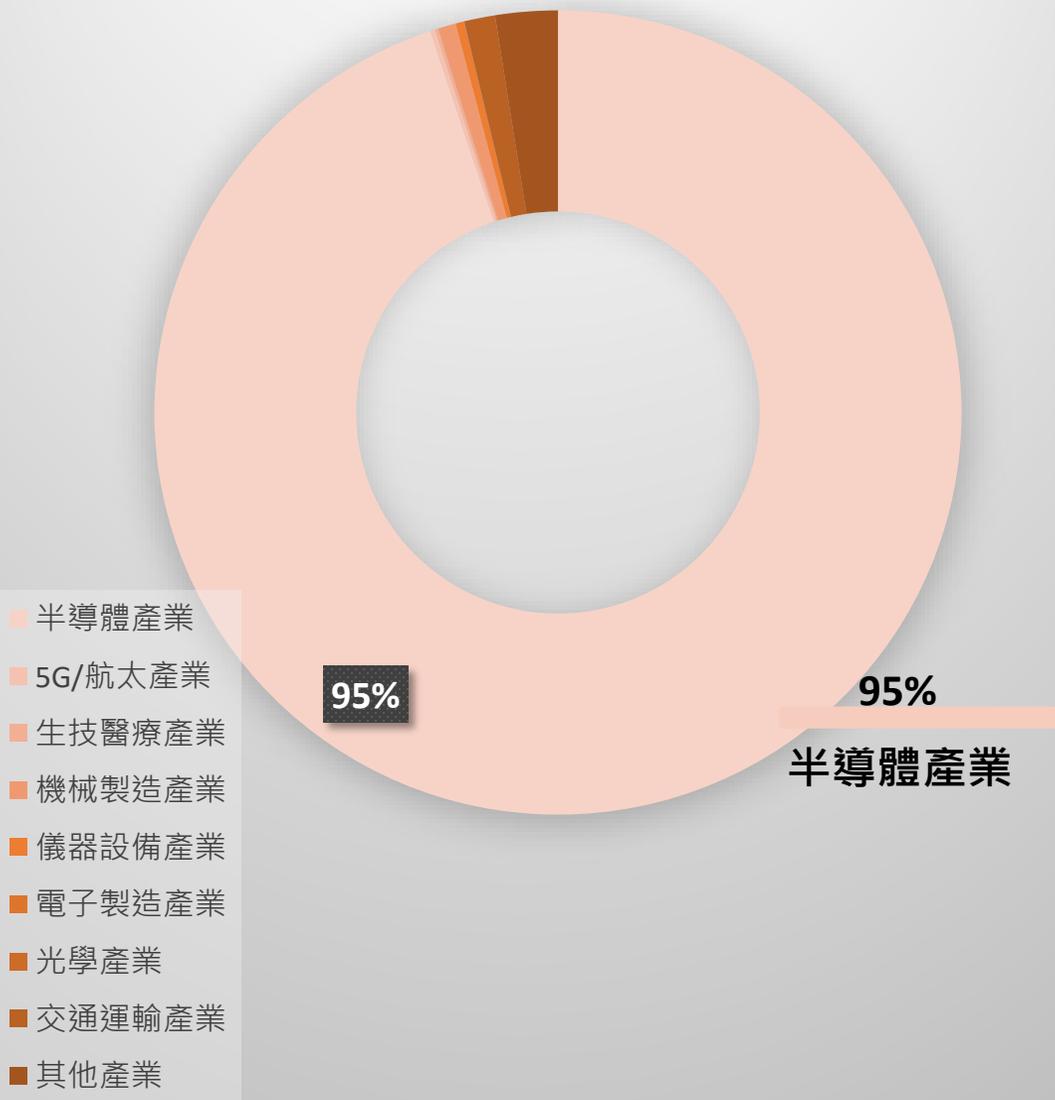
(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)



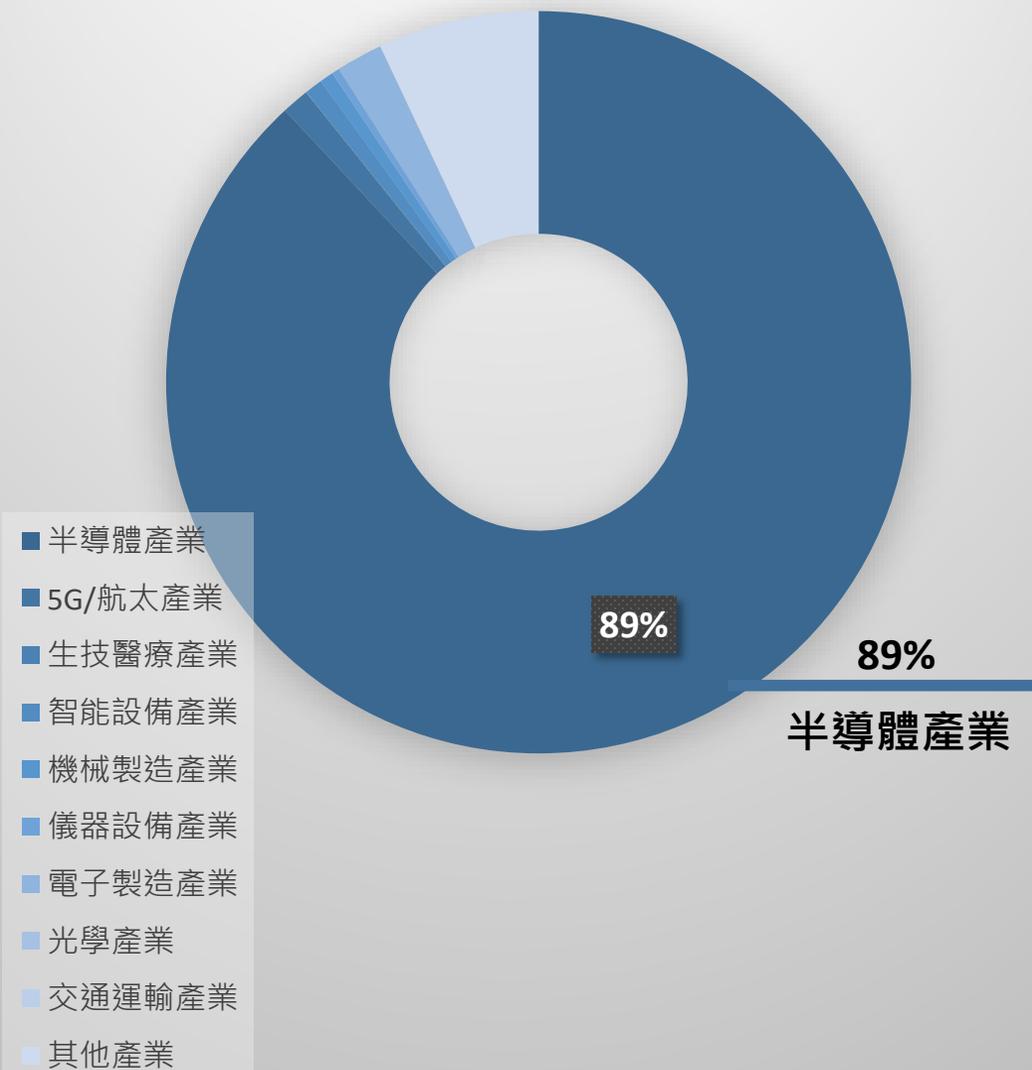
財務資訊

03

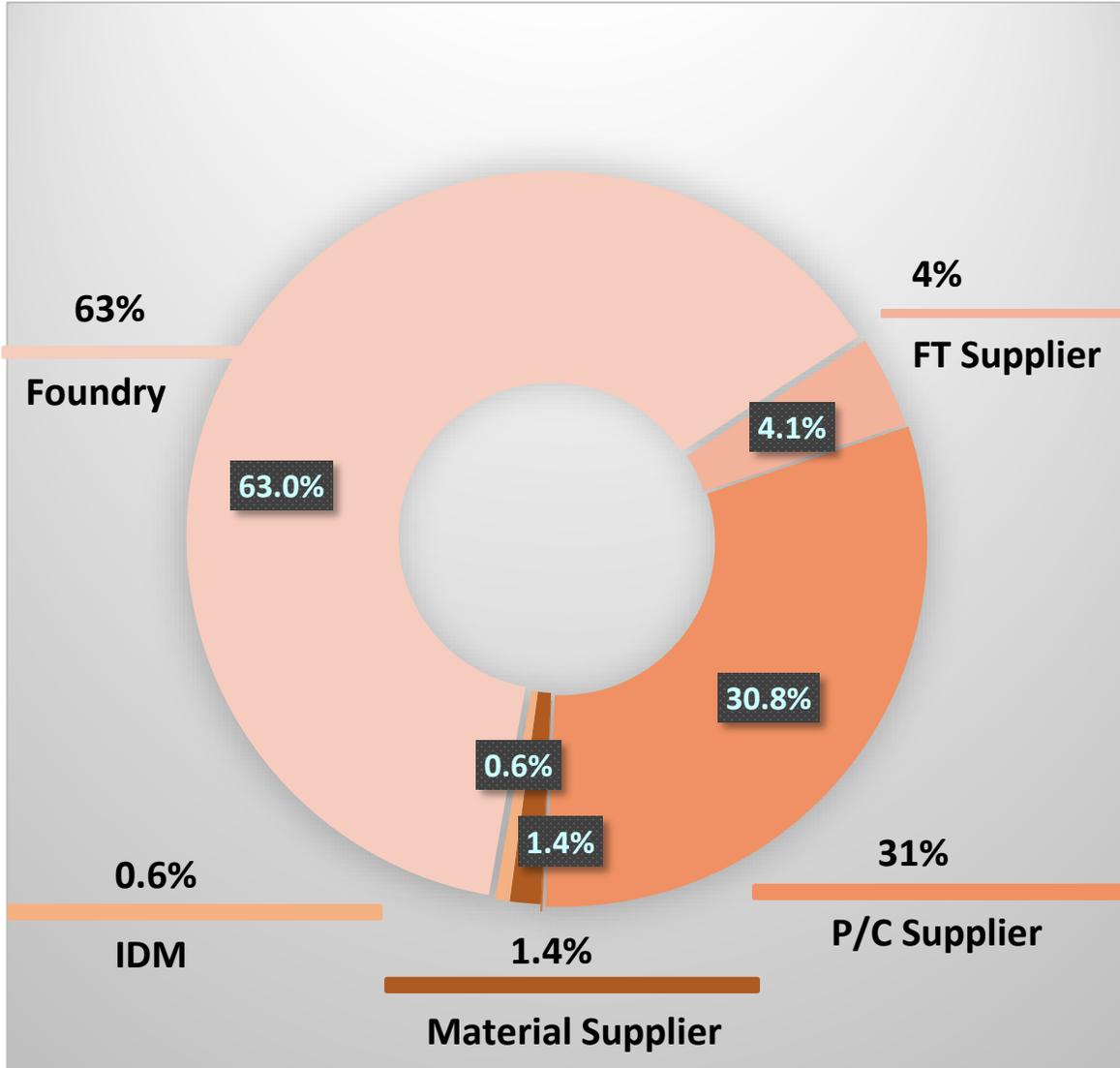
2024年 客戶產業別占比



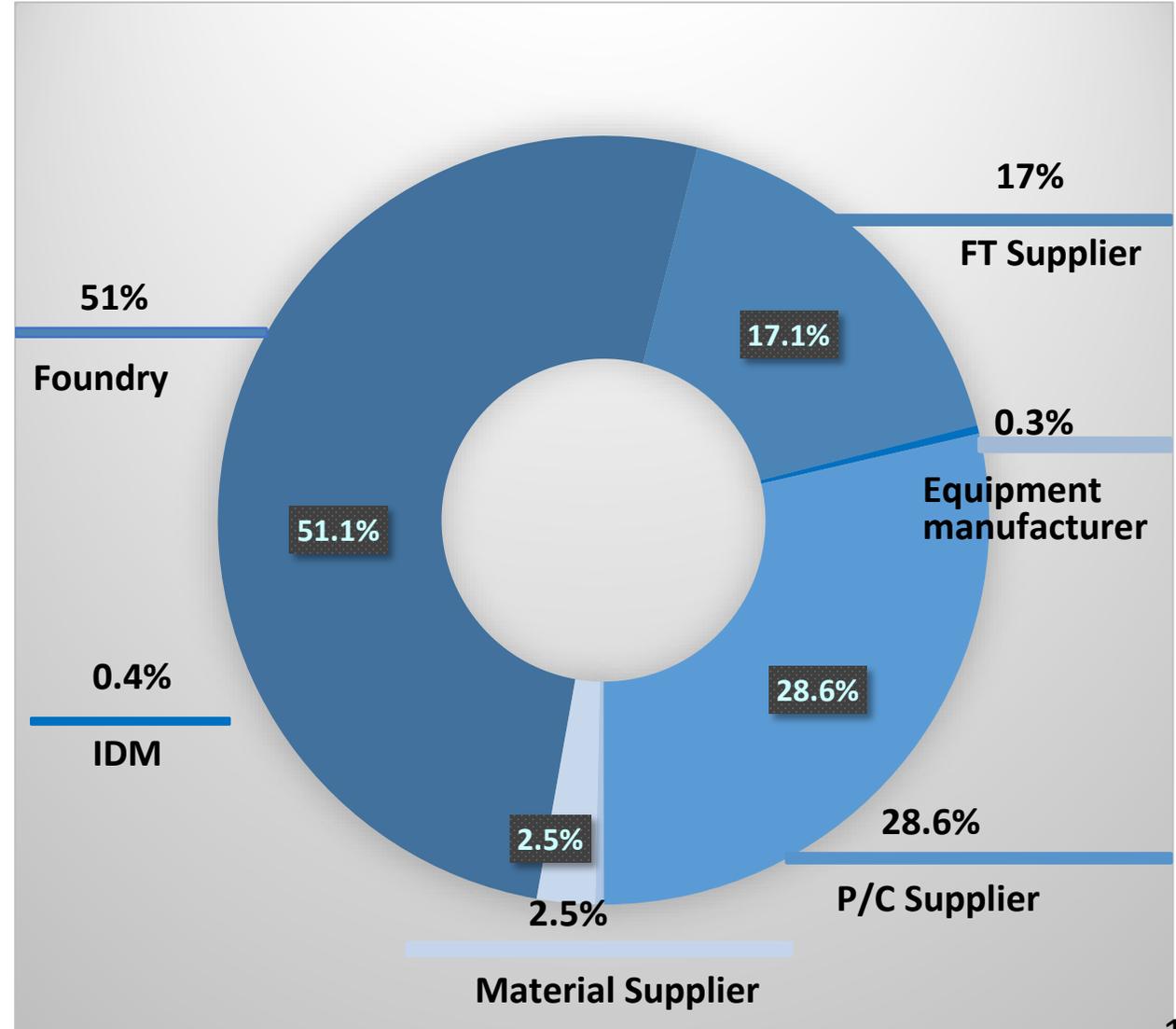
2025年 客戶產業別占比



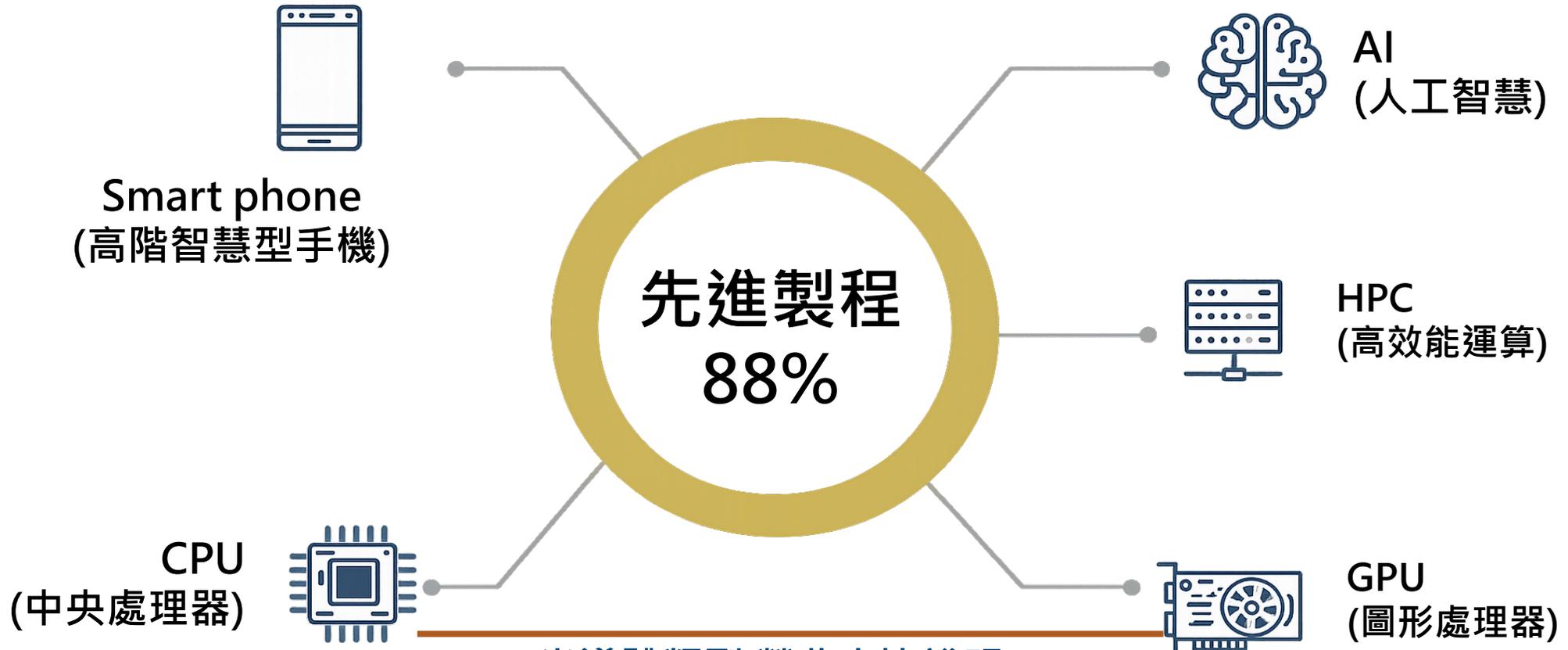
2024年 營收95% 半導體客戶類型



2025年 營收89% 半導體客戶類型



營收高度集中於先進製程 受惠於AI與HPC的強勁需求



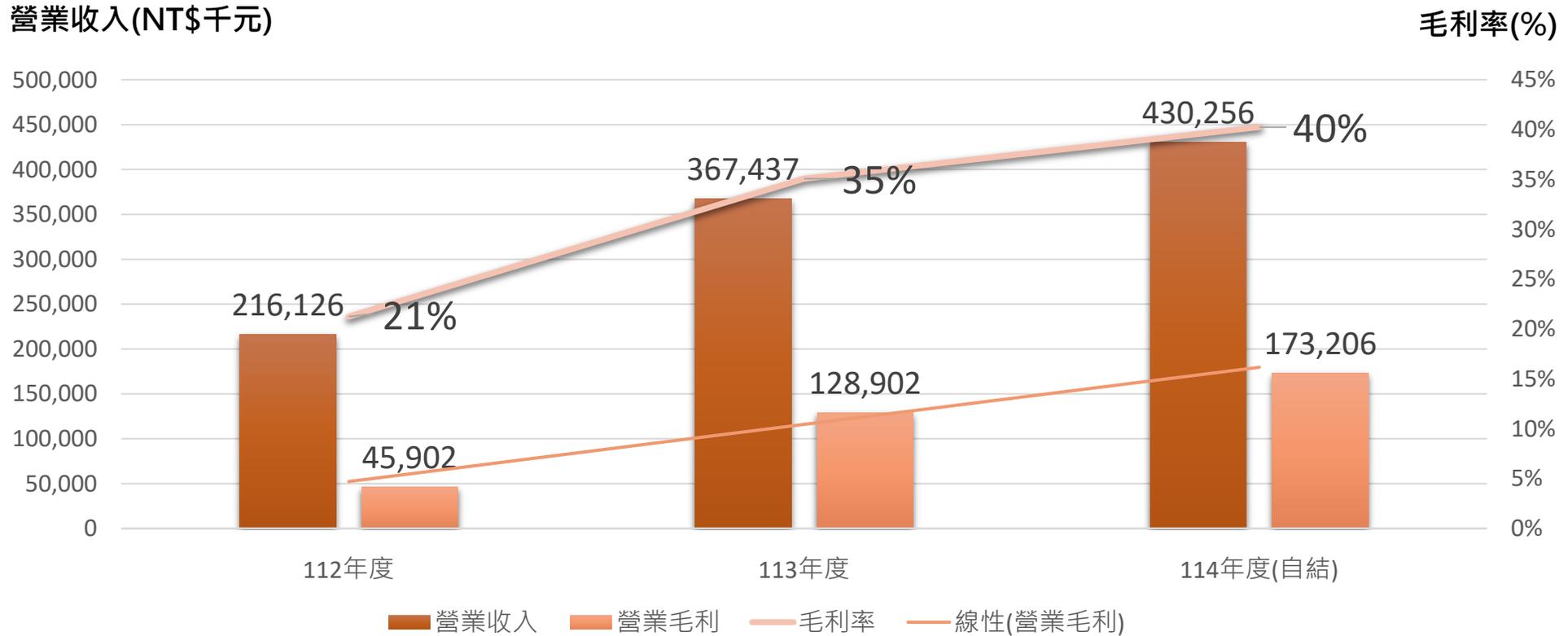
半導體類型 營收占比說明

先進製程 (Advanced Node) : 88%

成熟製程 (Mature Node) : 9%

其他 (Other) : 3%

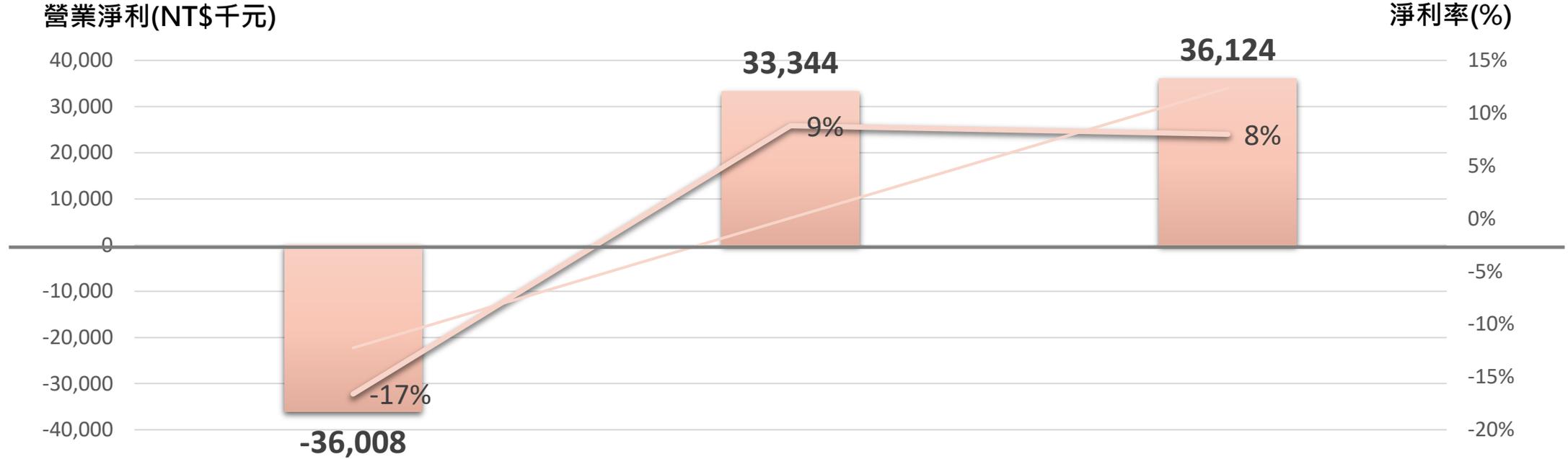
合作深化帶動營收成長 高附加價值推升毛利率



(單位: 新台幣仟元)	112年度	113年度	114年度(自結)
營業收入	216,126	367,437	430,256
營業毛利	45,902	128,902	173,206
毛利率	21%	35%	40%

「營收與毛利結構同步增長，展現強勁成長趨勢」

規模經濟與營運效率提升 實現淨利率由負轉正的顯著改善



(單位: 新台幣仟元)	112年度	113年度	114年度(自結)
營業淨利	(36,008)	33,344	36,124
淨利率	(17%)	9%	8%

「公司已進入穩定獲利軌道，未來獲利能力具備持續上升空間」

景美科技 7899.TW

全球信賴的半導體測試介面核心專家

(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)



投資亮點

04

站在巨人的肩膀上 共創價值的成長飛輪



實現共贏的商業價值

- 持續增加的NRE 及 組裝服務收入
- 持續成長的銷貨收入
- 其他設備及維修支援收入

深度整合 夥伴關係

- 研發服務：設計建議與協作 與 痛點解決方案
- 製造銷售服務：穩固訂單且維持長期的上、下游合作關係。

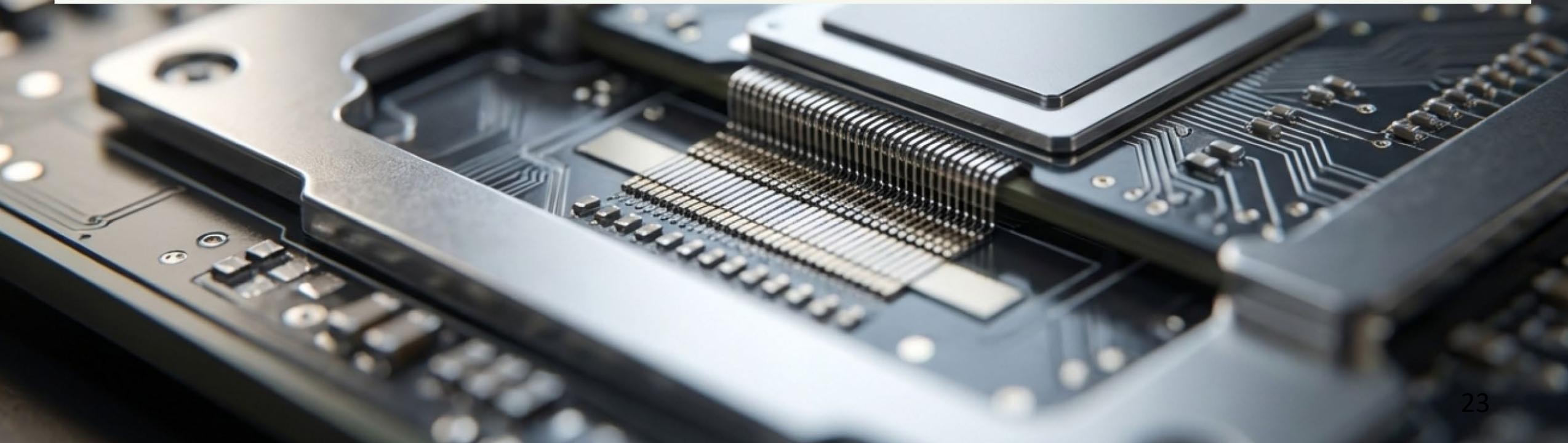
驅動多面向 成長需求

- 設計資源需求
- 產能需求
- 檢驗需求
- 專業夥伴的需求

信賴 源自對技術與品質的絕對堅持

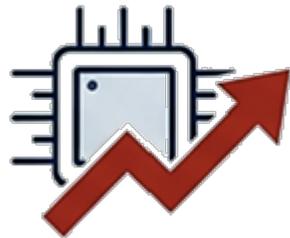


在這個要求零失誤的產業，信任無法輕易獲得。全球領導者共同選擇CMAT，是因為我們的技術能力滿足最嚴苛的規格，我們的品質承諾確保了最穩定的表現。這不僅是合作，更是我們對核心能力的認可。



景美科技: 長期價值的四大基石

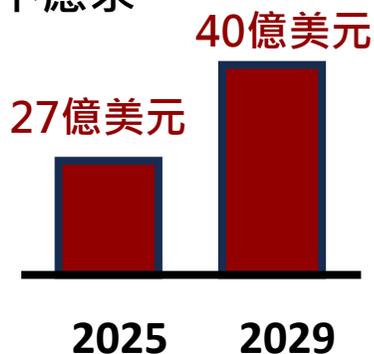
掌握先進製程關鍵，AI浪潮下的隱形冠軍



市場潛力

AI 與 HPC 強勁驅動

- 我們的技術是先進製程測試不可或缺的一環，直接受惠於AI蓬勃發展，市場供不應求。



資料來源:Techinsights



技術護城河

研發製造一體

- 獲巨人客戶高度信賴，品質與交期穩定
- 建構不可輕易取代的產業門檻，驅動中長期成長動能



全球布局

探針卡廠最強後盾

- 以夥伴思維深度嵌入供應鏈，是客戶可信賴的製造延伸與技術後盾。
- 與台灣、美、英、日、韓探針卡大廠建立深度合作。



營運績效

獲利體質強健

40%

毛利率顯著提升

78%

先進製程產品營收占比

2028年啟用第三座廠區，
產能再升級

景美科技 7899.TW

全球信賴的半導體測試介面核心專家

(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)

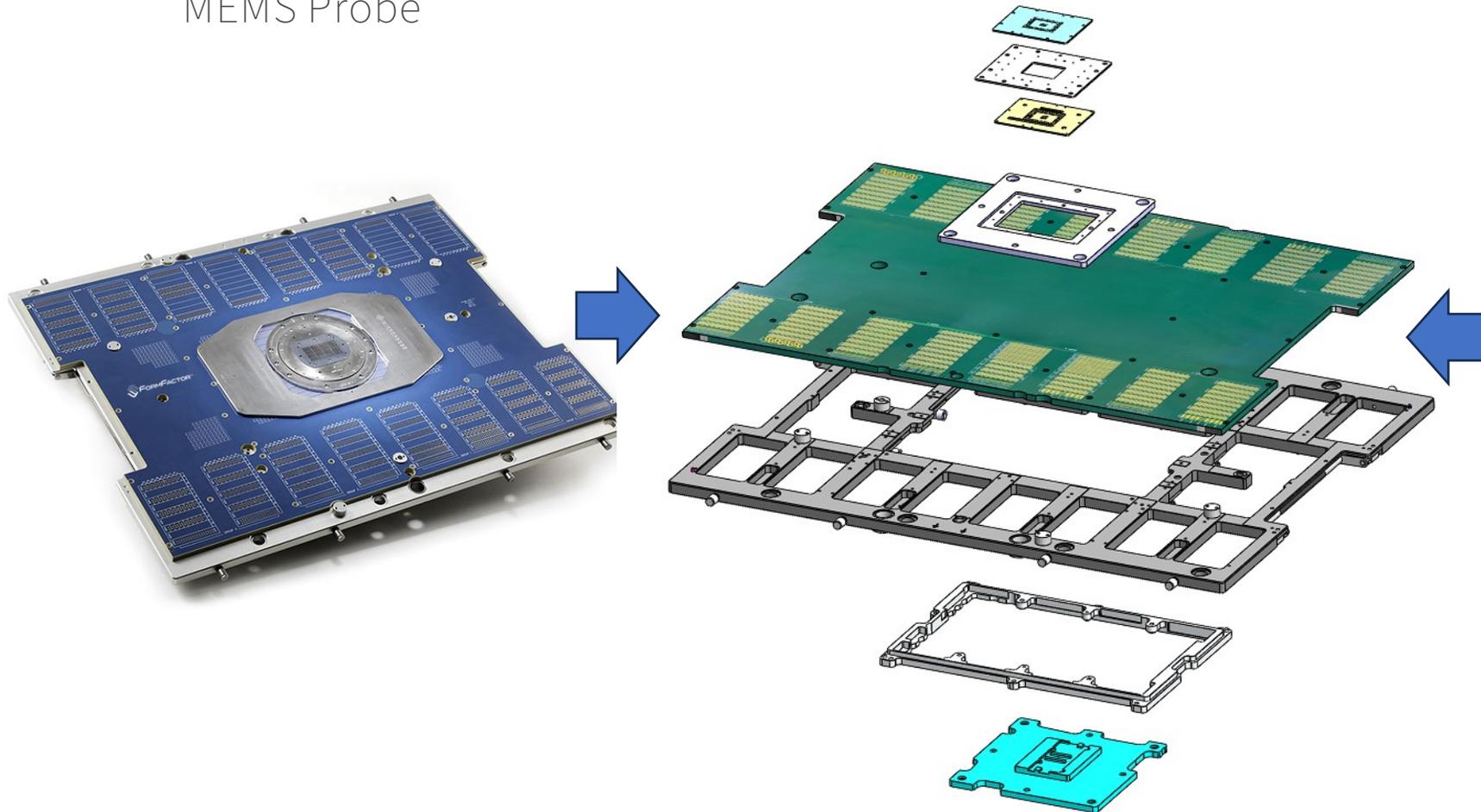


參考資料

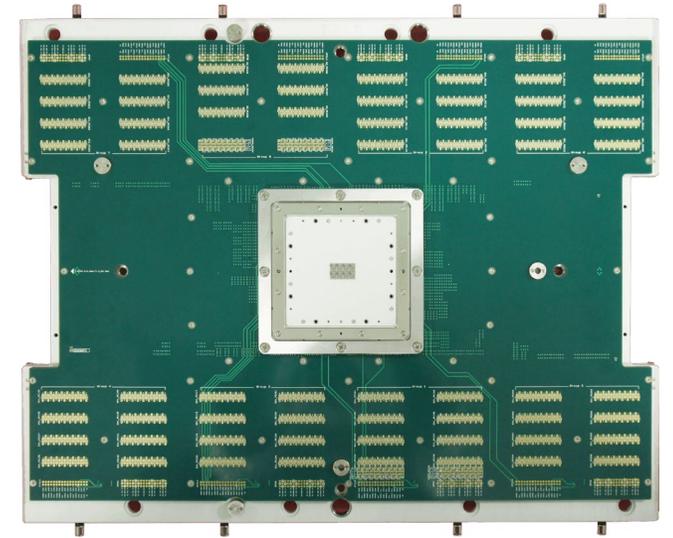
05

垂直式探針卡VPC

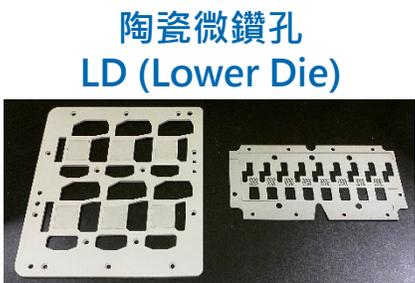
晶圓測試垂直探針卡 (VPC)
MEMS Probe



晶圓測試垂直探針卡 (VPC)
Cobra Probe



垂直式探針卡架構圖 (MEMS/Cobra)

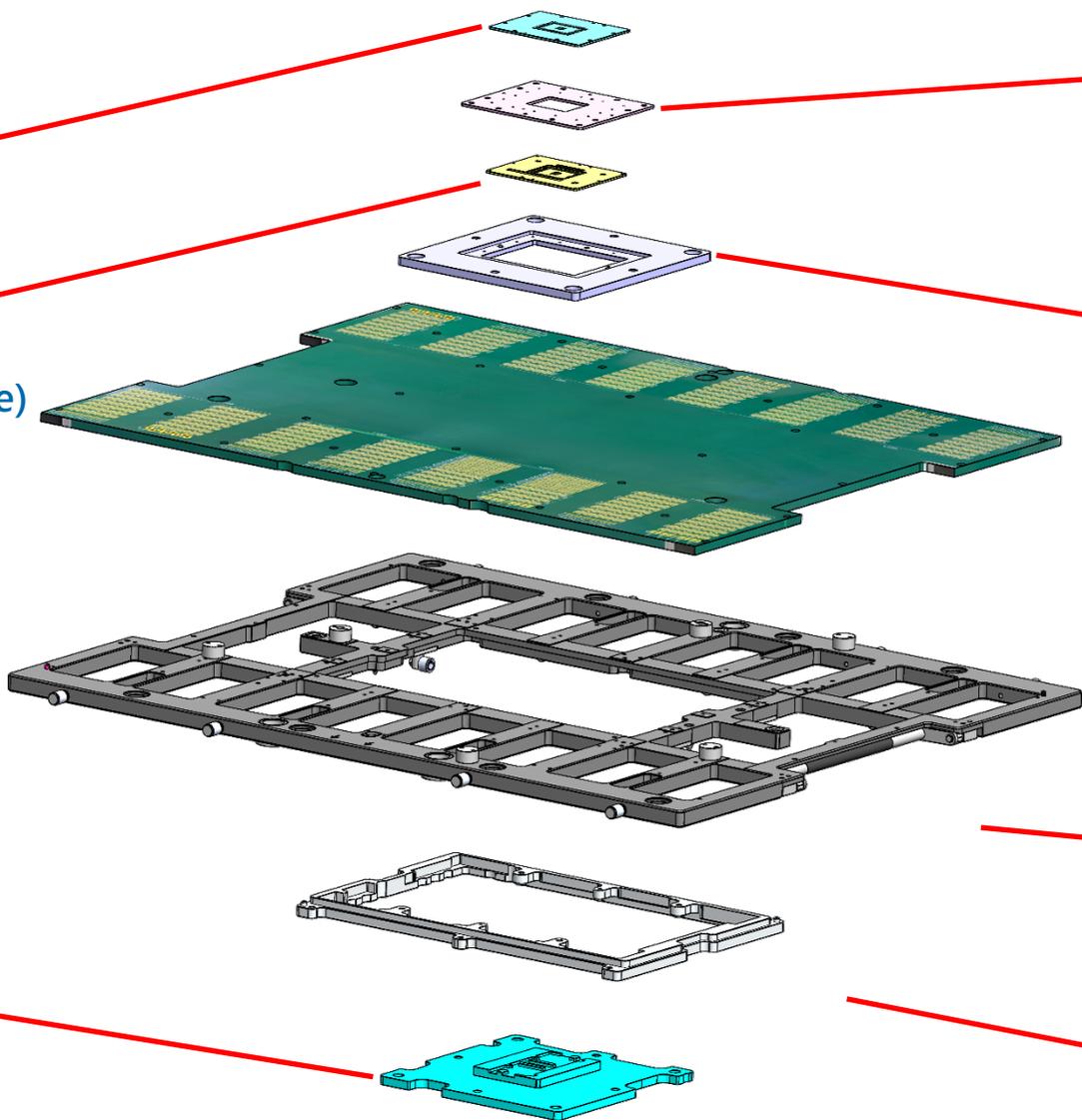
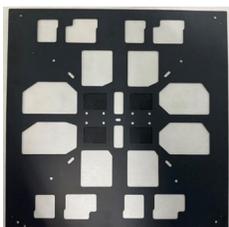


陶瓷微鑽孔
LD (Lower Die)

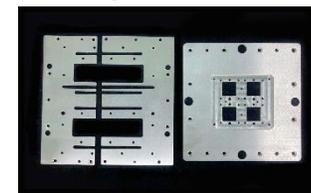
精密塑料 機械鑽孔
Socket Plate



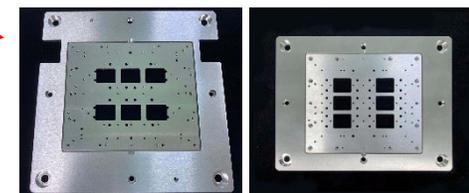
陶瓷微鑽孔
UD (Upper Die)



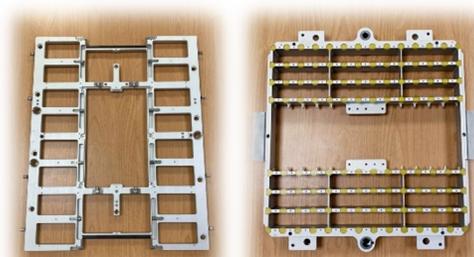
間隔件 (SUS420)
Spacer



P.H 乘載座(SUS420)
Jig



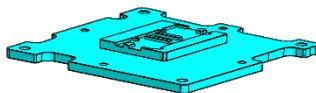
測試機機框
ATE stiffener
93K-DD stiffener



後支撐結構頂塊
Push base
後支撐結構板
Backer



結構補強框
(AL or SUS420)
Tester side support



未來五年台積電先進製程產能布建 近八成仍在台灣



2025~2030年積電先進製程產能布局狀況

業者	投資地點	廠區	製程	規劃月產能 (千片/12吋)	量產時點
台積電	台灣 新竹	Fab 20 P1, P2	N2/A16	100~120	4Q25
		Fab 20 P3, P4	A14		2028年
	台灣 高雄	Fab 22 P1, P2, P3	N2/A16	120~150	4Q25~2027
		Fab 22 P4, P5	N2/A16		2028年起
		Fab 22 P6	A14		新案評估中
台灣 台中	Fab 25 P1~P4	A14/A10	100~120	2028年起	
美國 亞利桑那州	Fab 21 P1	N4		4Q24	
	Fab 21 P2	N3/N2		2027/2028年	
	Fab 21 P3	N2/A16	200~250	2029~2030年	
	Fab 21 P4	N2/A16		待定	
	Fab 21 P5、P6	A14/A10		待定	
日本 熊本	Fab 23 P2	N6	50	2027→2028年	

景美科技 7899.TW

全球信賴的半導體測試介面核心專家

(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)



Q&A



7899.TW

Thanks

景美科技 (CMAT)

全球信賴的半導體測試介面核心專家

先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造